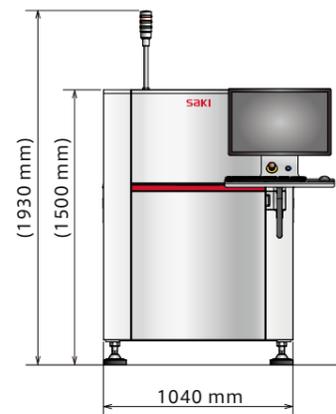
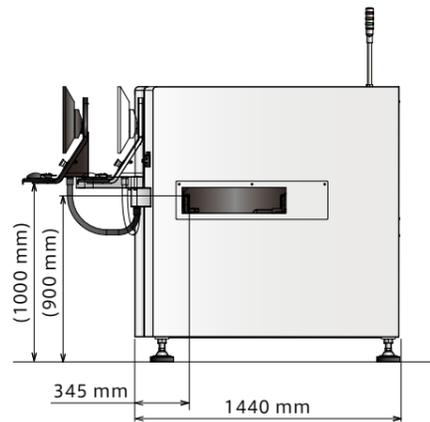


外観図

■ 正面図



■ 側面図



ハードウェア/機能仕様

モデル名	2Di-LU1
解像度	18 μm
基板サイズ (mm)	搬送可能サイズ:50(W)×60(L)-610×610 検査可能サイズ:50(W)×60(L)-460×500
基板厚	0.5 - 5.2 mm
基板重量	12 kg
部品高さ	上: 130 mm 下: 40 mm
耐熱温度	70°C以下
主要な検査項目	スルーホールはんだ検査 (赤目、はんだ少、はんだ過多、ブローホール、 ピンの有無、ブリッジ)
搬送コンベア方式	平ベルト搬送
搬送コンベア高さ	880 - 965 mm
オペレーティングシステム	Windows 10 IoT Enterprise 64bit 英語版 (Microsoft社製)
電源	単相~200V - 240V±10%、50/60Hz 700VA
供給エア	0.5MPa以上 5L/min (ANR)
使用環境	15 - 30°C / 15 - 80%RH (結露なきこと)
装置寸法 W x D x H	1040 x 1440 x 1500 mm
重量	約750 kg

インライン型プリント基板下面2D自動外観検査装置 2Di-LU1

最終工程自動化の実現へ、
スルーホールはんだ専用下面検査装置



saki 株式会社サキコーポレーション

本社
〒135-0051 東京都江東区枝川3丁目1-4
DMG MORI東京デジタルイノベーションセンタ
TEL:03-6632-7910 FAX:03-6632-7915

名古屋営業所
〒450-0002 名古屋市中村区名駅2丁目35番16号 DMG森精機名古屋本社4階
TEL:052-587-1853 FAX:052-587-1854

西日本営業所(奈良)
〒639-1160 奈良県大和郡山市北郡山町106番地
TEL:0743-87-9845 FAX:0743-87-9950



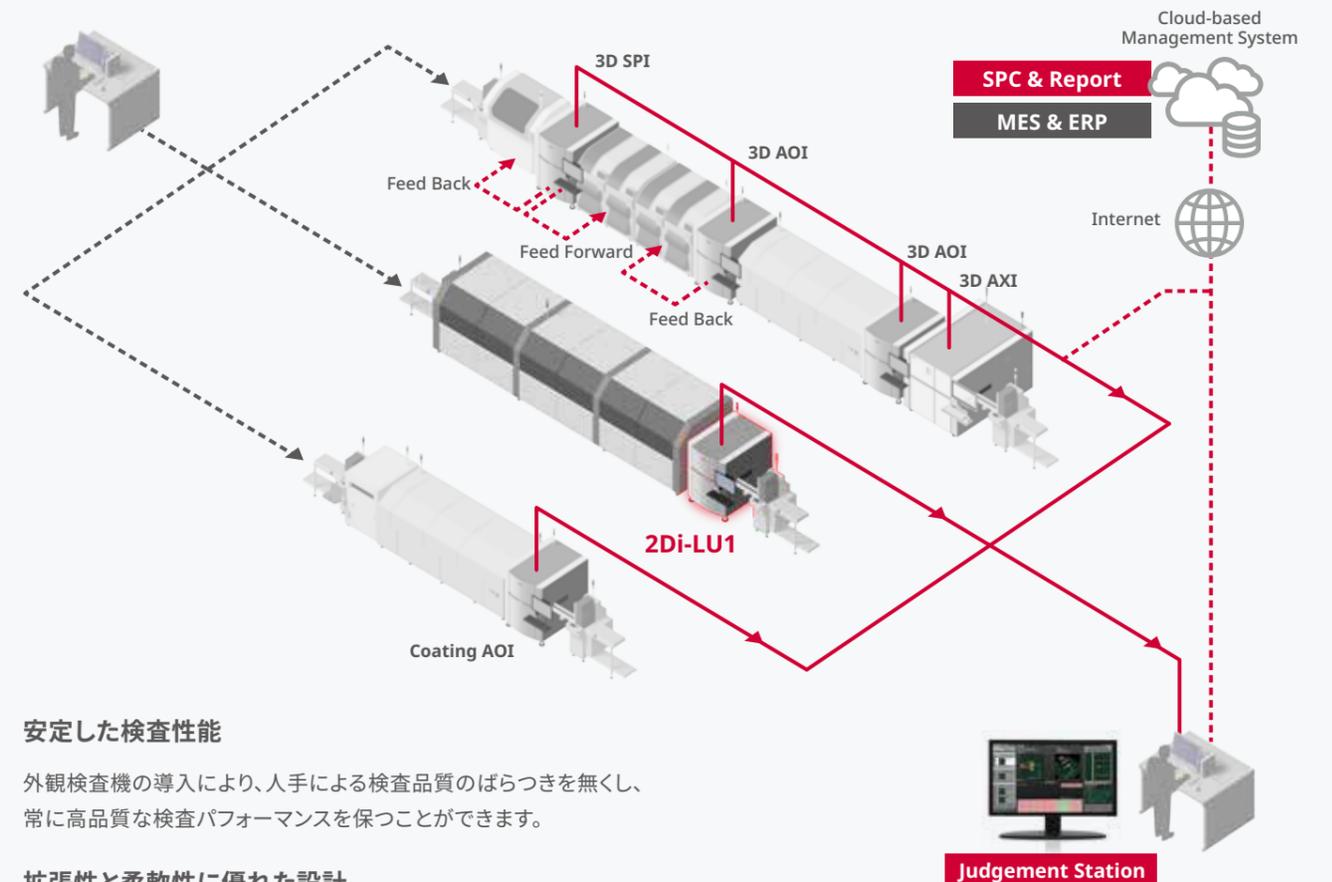
基板実装の最終工程自動化へ向けた下面検査装置

セレクトティブ・ウェーブ・ディップソルダリング工程後のスルーホールはんだ部品の品質を保証、生産性を向上します。

プリント基板実装の最終工程を自動化する2D-AOI設備です。
 検査結果と共に基板上のNG箇所やOK基板全体画像を出力することができます。
 基板の反転が不要なため、反転機や人手による基板ハンドリングのダメージを防止します。



SAKI トータルソリューション



安定した検査性能

外観検査機の導入により、人手による検査品質のばらつきを無くし、常に高品質な検査パフォーマンスを保つことができます。

拡張性と柔軟性に優れた設計

お客様の多種多様な生産状況に対応するため、生産管理システムへの統合や、生産ラインへの組み込みが容易となる、拡張性の高いハードウェアソフトウェア設計を採用しています。

特長1 ハードウェア

SAKIのラインスキャン方式による高速検査

独自のラインスキャン撮像方式を下面検査に応用しました。高速撮像により大型基板を約9秒で一括検査します。新たに開発した高剛性コンベアが大型異形挿入部品搭載基板や重量治具に対応します。またスキャナー部を強化ガラスで覆うことでフラックスや異物などの落下に対応しました。容易に清掃が可能です。

- 最大基板サイズ 460×500 mm
- 最大搬送重量 12 kg
- 基板クリアランス 上面:130 mm 下面:40 mm

下面スキャン



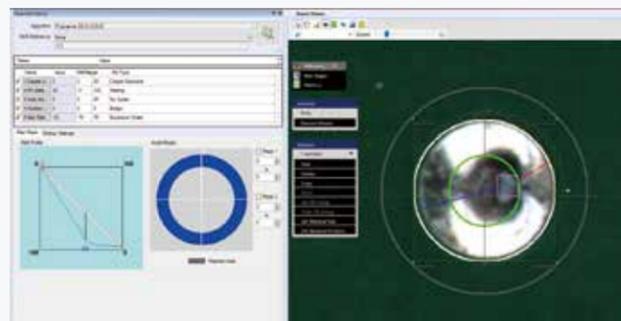
特長2 ソフトウェア

実績のある検査アルゴリズム

定評あるスルーホールはんだ検査専用アルゴリズム、FUJIYAMAを搭載しました。

- 独自の照明技術ではんだ形状を抽出して、
- 赤目=はんだ無し
 - はんだ少
 - はんだ過多
 - ブローホール
 - ピンの有無
 - ブリッジ
- の異常を1つの検査ウィンドウで同時に検査します。

FUJIYAMAのユーザーインターフェース

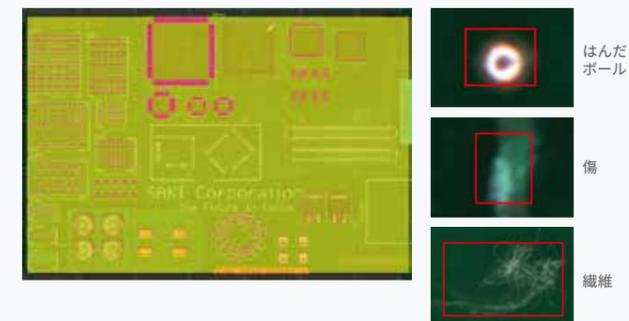


余剰部品検査機能 (ECD)

ラインスキャン方式では、基板全面を一括撮像します。通常のはんだ検査と同時に基板全域で異常を検知することができます。

- 数枚の良品基板の画像から平均的なOK画像を生成します。スキャン画像とOK画像を比較することで、
- プラスチックモールドの欠け
 - 落下したチップ部品
 - リールテープの破片
 - 異物
 - 基板のパターン異常
 - はんだ付けフレーム破損
- など予期しない不具合を自動検出します。

ECD検査ウィンドウ



特長3 SAKI トータルソリューション

実績のある検査アルゴリズム

はんだ印刷検査装置 (SPI)、リフロー後検査装置 (AOI) と共通のソフトウェアプラットフォームを採用した新しい2D-AOIです。

- CADデータからの検査データの自動生成
- シンプルで使いやすいインターフェース
- 不良箇所の確認画面
- オフラインでのデータ作成
- 検査結果の統計処理

などの、SPI/AOIと共通システムオプションを使用することにより、オペレーションが統一されてオペレーターの作業負担を軽減します。メンテナンスやサービスパーツも共通のため、保守も容易になります。

BF2-Monitor画像

